

M-VIA Embedded[®]部品内蔵基板

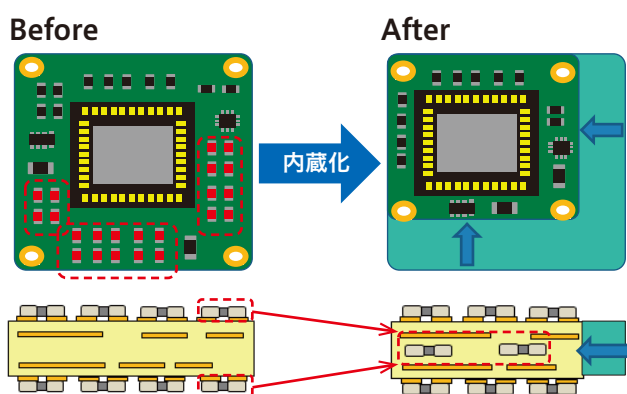
Embedded Devices PWB

特長 Features

- ✓ 小型化、薄型化、搭載容量の増加
Downsizing, Thinner, Increase of Mounting Capacity
- ✓ 配線長の短縮による低インダクタンス化、低ノイズ化
Shortening the Path to Devices (Low Inductance, Low Noise)

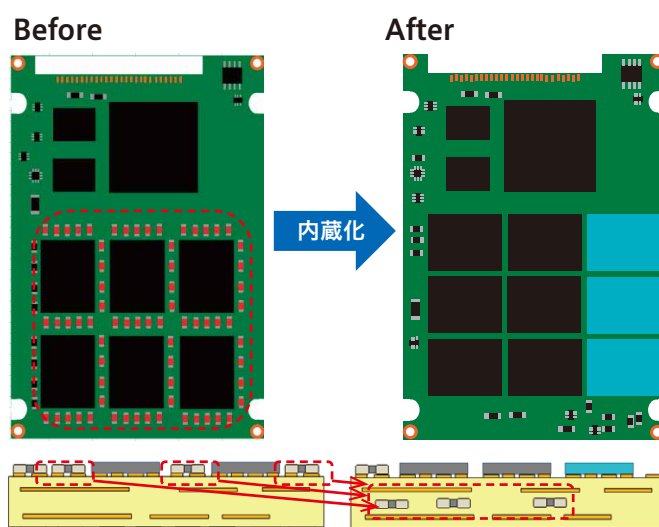
部品内蔵化による小型化

Downsizing by Embedding Chip Components



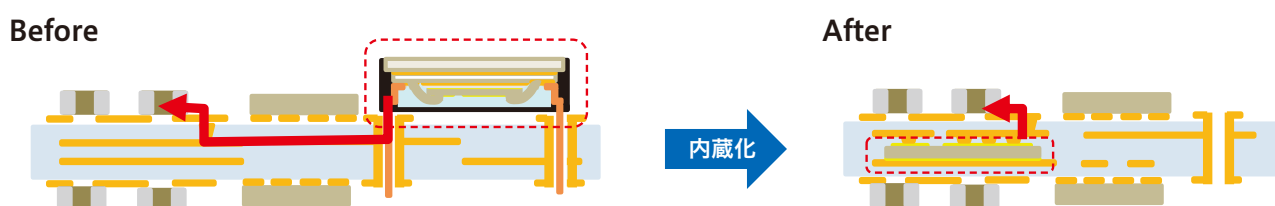
部品内蔵化による部品搭載容量の増加

Increase of Mounting Capacity by Embedding Chip Components

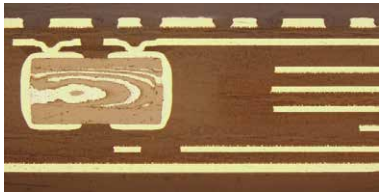
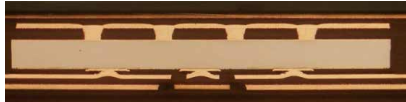


配線の短縮化による低インダクタンス、低ノイズ化

Low Inductance, Low Noise by Shortening the Path to Devices



基板構造 PWB Structure

パッシブ部品内蔵基板 Embedding Passive Components 量産中	アクティブ部品内蔵基板 Embedding Active Components R&D	パワー素子内蔵基板 Embedding Power Devices R&D
めっき片面接続 Laser Attachment (Single-Sided)	めっき両面接続 Laser Attachment (Double-Sided)	厚銅めっき両面接続 Laser Attachment (Thick Cu Double-Sided Plating)
		
用途: カメラモジュール、 医療用モジュール、 通信モジュール、メモリードライブ等 Application: Camera Module, Medical Module, Communication Module, Memory Drive, etc	用途: バッテリーモジュール、 アンテナモジュール等 Application: Battery Module, Antenna Module, etc	用途: DCDCコンバータ、インバータ等 Application: DC-DC Converter, Inverter, etc